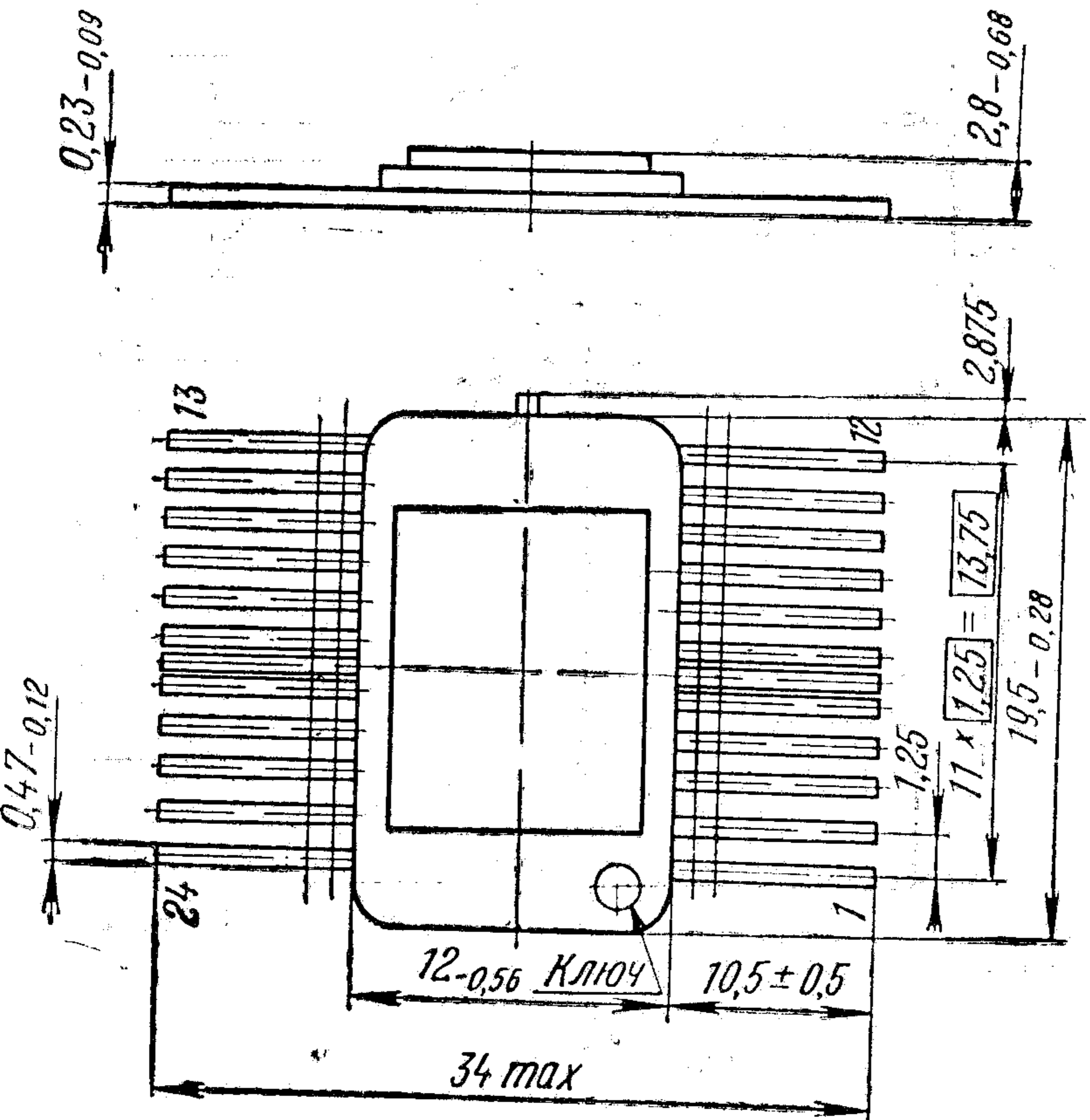


# МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 528

## Общие данные

### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ МИКРОСХЕМ 528БР2 (корпус 405.24-2)



### ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Нумерация выводов микросхем показана условно.

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц . . . . .	от 1 до 5000
амплитуда ускорения, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g) . . . . .	400 (40)

Механический удар:

одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g) . . . . .	15 000 (1500)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 0,1 до 2

многократного действия:	
пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g) . . . . .	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 1 до 5
Линейное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g) . . . . .	5000 (500)
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)	665 (5)
Атмосферное повышенное давление, атм . . . . .	3
Повышенная температура среды, °С:	
для микросхемы 528ХК1 . . . . .	85
для микросхем 528БР1, 528БР2, 528ФВ1 . . . . .	70
Пониженная температура среды, °С . . . . .	минус 60
Изменения температуры среды, °С:	
для микросхемы 528ХК1 . . . . .	от минус 60 до +85
для микросхем 528БР1, 528БР2, 528ФВ1 . . . . .	от минус 60 до +70
Иней, роса.	
Соляной туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка*, ч . . . . .	50 000
Срок сохраняемости*, лет . . . . .	25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—82 и требованиями, изложенными ниже.

Допустимое значение статического потенциала 30 В.

Приклейку микросхем производить клеем АК-20. Допустимая толщина клея не более 0,4 мм.

При пайке микросхем групповым способом температура жала паяльника не более 265°С, время воздействия не более 2 с, расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм, интервал между двумя повторными пайками одной микросхемы не менее 5 мин. При пайке рекомендуется применять припой ПОС Су-61-0,5 и флюс ФКСп.

Микросхемы в блоках аппаратуры, при необходимости, покрывают влагозащитным лаком УР-231 или ЭП-730. Количество слоев — 3.

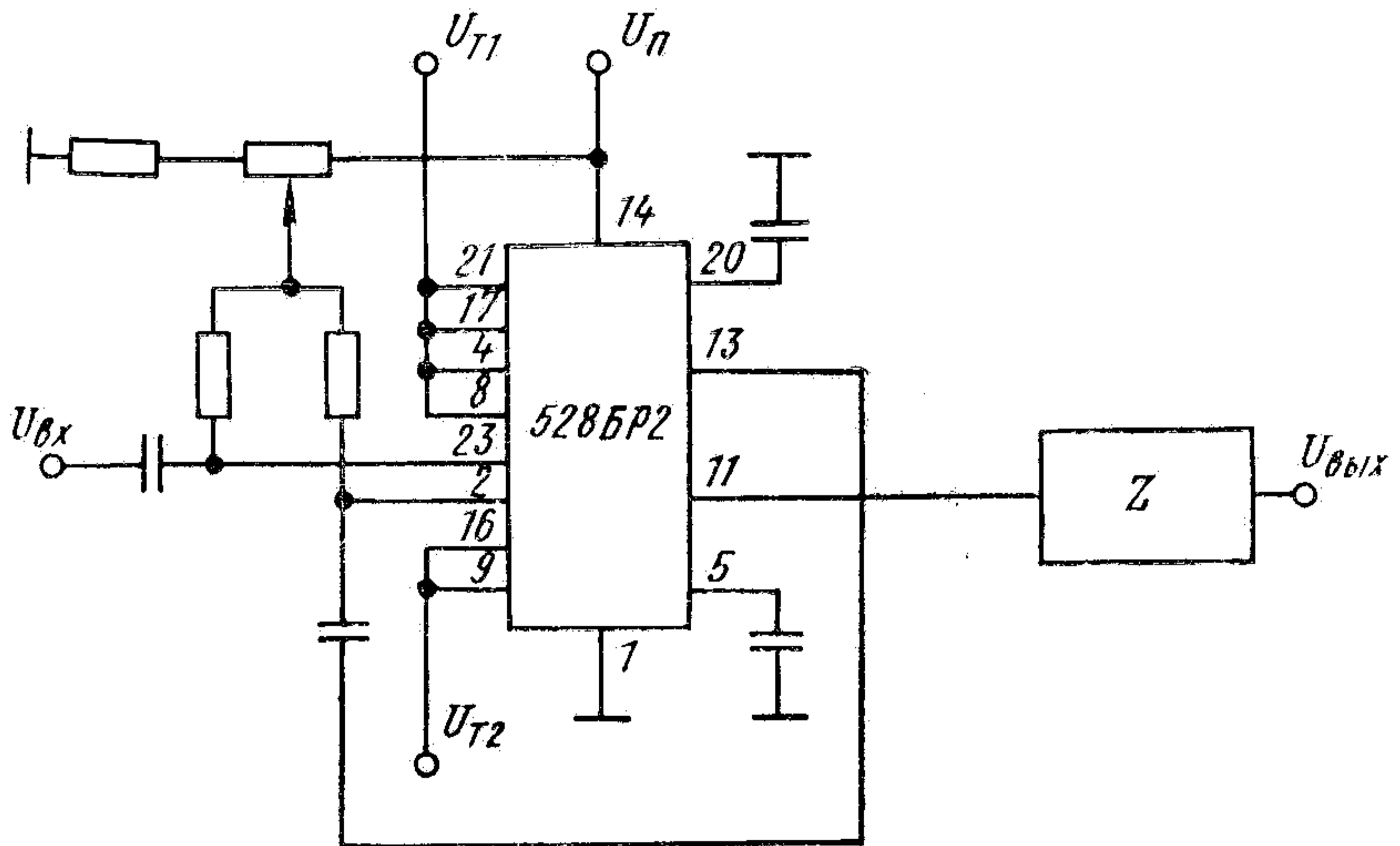
При хранении, транспортировании и обращении микросхемы должны находиться в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей закорачивание всех выводов. Выводы плат с микросхемами во время распайки, лакировки, хранения, транспортирования должны быть замкнуты и по возможности заземлены.

\* В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

- |                  |                 |                    |
|------------------|-----------------|--------------------|
| 1 — подложка     | 9 — $U_T$ (2-2) | 16 — $U_T$ (2-1)   |
| 2 — вход 2       | 10 — свободный  | 17 — $U_T$ (1-1)   |
| 3 — свободный    | 11 — выход 2    | 18, 19 — свободные |
| 4 — $U_{B2}$     | 12 — $U_{CM3}$  | 20 — $U_{CM1}$     |
| 5 — $U_{CM2}$    | 13 — выход 1    | 21 — $U_{B1}$      |
| 6, 7 — свободные | 14 — $U_P$      | 22, 24 — свободные |
| 8 — $U_T$ (1-2)  | 15 — свободный  | 23 — вход 1        |

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ



Z — фильтр нижних частот

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре  $25 \pm 10^\circ\text{C}$ )

Напряжение питания, В . . . . .	$15 \pm 2\%$
Напряжение управляющих тактовых импульсов, В	15
Ток потребления, мА, не более . . . . .	1,8
Коэффициент усиления напряжения . . . . .	от 0,8 до 1,6
Коэффициент неравномерности АЧХ, дБ, не более	5

Коэффициент гармоник, %, не более . . . . .	4
Напряжение шумов, приведенное ко входу, мВ, не более . . . . .	3

Предельно допустимые значения параметров  
и режимов эксплуатации

Максимальный ток потребления, мА . . . . .	1,8
Коэффициент усиления напряжения . . . . .	от 0,8 до 1,6
Коэффициент неравномерности АЧХ, дБ . . . . .	5
Приведенное ко входу напряжение шумов, мВ . . . . .	3
Максимальный коэффициент гармоник, % . . . . .	4